

GENERATIVE FERTIGUNGSVERFAHREN IN DER ELEKTRONIK

Faxantwort: +49 8153 9097 -511

Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration IZM
David Ifland
Argelsrieder Feld 6 | 82234 Oberpfaffenhofen

Anmeldung:

Technologieforum »Generative Fertigungsverfahren
in der Elektronik«

Vorname, Name _____

Firma _____

Abteilung _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

Unterschrift _____

Veranstaltungstermin

Mittwoch, 13. und Donnerstag, 14. März 2013

Veranstaltungsort

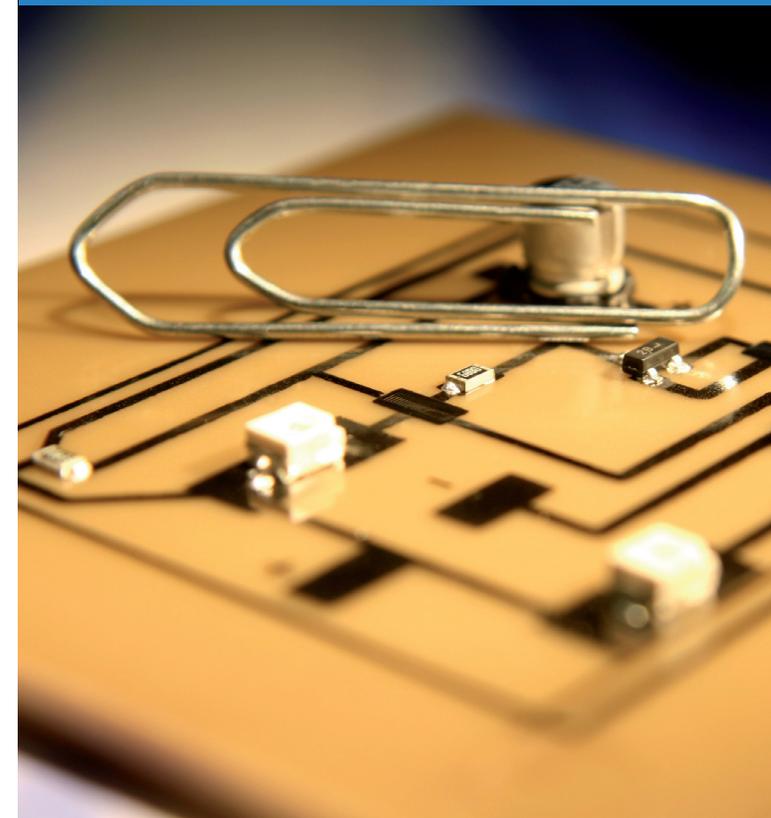
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit
und Mikrointegration IZM
Argelsrieder Feld 6 | 82234 Oberpfaffenhofen
Tel: +49 8153 9097 -500
Fax: +49 8153 9097 -511

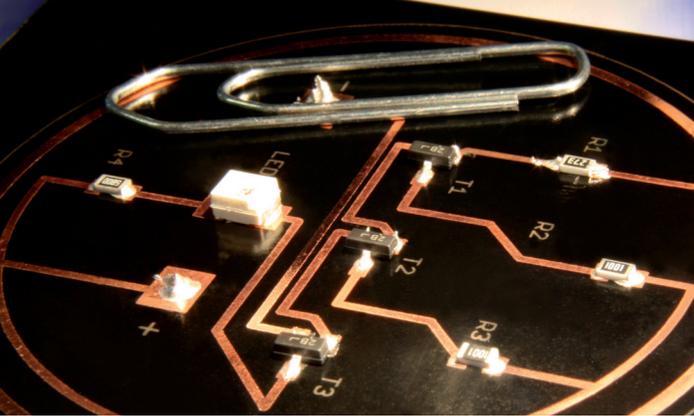
Anmeldung und Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt 280 €.
Bitte melden Sie sich schriftlich bis zum **26. Februar 2013**
mit dem nebenstehenden Vordruck per Brief oder Fax an.
Sie erhalten dann umgehend eine Anmeldebestätigung und
Rechnung.

Lage- und Anfahrtsplan

Eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung mit Skizze finden Sie
im Internet unter <http://www.izm.fraunhofer.de/de/kontakt.html>
unter Abteilungen/Standorte »Oberpfaffenhofen«.





MITTWOCH, 13. MÄRZ

DONNERSTAG, 14. MÄRZ

TECHNOLOGIEFORUM

Generative Fertigungsverfahren in der Elektronik

Das Forum wird im Rahmen der Fraunhofer-Allianz Generative Fertigung veranstaltet. Diese Allianz integriert deutschlandweit 11 Institute und bildet damit die gesamte Prozesskette der generativen Fertigung ab. Dies umfasst die Entwicklung, Anwendung und Umsetzung generativer Fertigungsverfahren und Prozesse.

Im Kontext zukünftiger generativer Fertigungsverfahren stellen individuelle, volladditive und maskenlose Strukturierungstechnologien wie der Aerosol- und der elektrisch funktionale Inkjet-Druck eine wegweisende Technologie dar. Des Weiteren wird die Integration von elektronischen Komponenten durch die Nutzung der generativen Fertigungsverfahren angestrebt. Diese Technologien, auch unter »Direct Digital Manufacturing« (DDM) bekannt, erlaubt den Auftrag verschiedenster Materialien. Dabei rückt die Herstellung von Endprodukten durch die Nutzung der generativen Technologien stetig in den Vordergrund und löst die reine Anwendung als Prototypen-Equipment mehr und mehr ab.

Während des Forums werden verschiedene Technologien und Forschungsgebiete vorgestellt und konkrete technische Anwendungen erörtert. Es soll Interessierten einen Einblick in aktuelle und zukunftssträchtige Anwendungen auf dem Gebiet der generativen Fertigungsverfahren in der Elektronik geben.

- 14.00 Uhr Begrüßung und Einführung**
D. Ifland, Fraunhofer IZM
- 14.15 Uhr Löten ade – elektronische Systeme aus dem Drucker**
Dr.-Ing. F. Ansorge, Fraunhofer IZM
- 14.35 Uhr Elektrische Funktionalisierung von Thermoplasten mittels Inkjet-Druck von Ag-Nanotinten**
Prof. Dr.-Ing. M. Reichenberger, Georg-Simon-Ohm-Hochschule
- 15.05 Uhr Possibility for Electrical Contacting of Printed Layers**
T. Rossner, Technische Uni Darmstadt
- 15.35 Uhr Kaffeepause**
- 16.00 Uhr Gedruckte Elektronik und Sensorik mittels digitaler Druckverfahren**
Dr. V. Zöllmer, Fraunhofer IFAM
- 16.30 Uhr Inkjet-Druck als Produktionsverfahren für gedruckte Elektronik**
Dr. M. Doran, Notion Systems GmbH
- 17.00 Uhr Heterointegrationstechnologien in Folien**
Prof. Dr.-Ing. K. Bock, Fraunhofer EMFT
- 19.00 Uhr Gemeinsame Abendveranstaltung**

- 09.30 Uhr 3D Printed Electronics via Aerosol Jet Printing**
Dr. M. Hedges, Neotech Services MTP
- 10.00 Uhr Vorteile der Bauteilherstellung mittels Aerosoldruck- Anwendungen und Beispiele**
Dr. N. Mechau, Innovationlab GmbH
- 10.30 Uhr Kaffeepause**
- 11.00 Uhr RFID-Integration mittels Laser Strahl schmelzen**
C. Aumund-Kopp, Fraunhofer IFAM
- 11.30 Uhr 3D Function Speciment in the Rapid Prototyping Process**
Dr. L. Tröger, Harting AG
- 12.00 Uhr Generative Fertigungstechnologien für eine Direktintegration von mikroelektronischen Komponenten und Kontaktstrukturen**
D. Ifland, Fraunhofer IZM
- 12.30 Uhr Mittagessen**
- 13.30 Uhr Ende der Veranstaltung**